

世界一の製品を狙う先端基板の最新加工技術

開催期日:平成16年11月26日(金)

申込締切:平成16年11月19日(金)

主催:精密工学会

企画:事業部企画第2グループ

協賛:RP 産業協会/SME 東京支部/応用物理学会/エレクトロニクス実装学会/大田区産業振興協会/型技術協会/計測自動制御学会/研削砥石工業会/研磨布紙協会/自動車技術会/全日本プラスチック製品工業連合会/素形材センター/ダイヤモンド工業協会/超硬工具協会/電気加工学会/電気学会/砥粒加工学会/日本液晶学会/日本オプトメカトロニクス協会/日本金型工業会/日本機械学会/日本木型工業会/日本金属学会/日本金属プレス工業協会/日本光学会/日本光学測定機工業会/日本工具工業会/日本工作機械工業会/日本工作機器工業会/日本合成樹脂技術協会/日本小型工作機械工業会/日本材料学会/日本セラミックス協会/日本塑性加工学会/日本鍛造協会/日本ダイカスト協会/日本半導体製造装置協会/発明協会東京支部/表面技術協会/プラスチック成形加工学会/レーザ加工学会

世界一の製品を狙う日本のモノづくり技術の強化が急務になっています。競争力のある強い製品を狙うためには、キーコンポーネント部品の独自加工技術が必須となると言っても過言ではありません。特に半導体では小型化、薄肉化、高集積化が進み、ゴマ粒サイズのチップが流通管理に革命を起こす状況になってきました。また、ディスプレイでは新機種開発と共に省電力化が求められており、50インチハイビジョン化が進められながら、従来のブラウン管に比べてはるかに高い省エネルギーを達成しています。

そこで、半導体、ディスプレイを対象とした先端基板材の最新加工技術に関する講習会を企画いたしました。Siウエハの加工はもとより、フォトマスク用基板、基板露光、微小チップのハンドリング技術、ディスプレイ用カラーフィルタ製造技術等、幅広い最新加工技術について講演していただきます。様々な分野の基板加工に幅広く参考になるとともにと思っておりますので、多くの方々のご参加をお願いいたします。

日 時:平成 16年11月26日(金)、10時00分～17時20分

会 場:工学院大学 新宿キャンパス 11階第5会議室(〒163-8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2)

* JR(山手線・中央線・埼京線)、京王線、小田急線、地下鉄(丸の内線・都営新宿線)「新宿駅」下車西口より 徒歩 5 分

* 大江戸線 都庁前駅 直結

* 会場 URL: <http://www.kogakuin.ac.jp/map/shinjuku/index.html>

司 会:西口 隆(株式会社日立製作所)、大谷 幸利(東京農工大)、高松 浩司(株式会社東芝)

次 第

時間	題目	内容	講師
10:00～11:00	超 LSI デバイス用シリコン基板に関する課題	半導体デバイスの微細化と高性能化に伴い、その基板材料である Si 結晶ウエハは大口径化および一層の高品質化が要求されている。本講演では、大口径化および高品質ウエハにとって重要な加工プロセス、さらに品質検査に関する課題および最近の技術動向を解説する。	東芝セラミックス株式会社 シリコンカンパニー 技術統括部 加工技術部 加工技術第二担当 課長 泉妻 宏治
11:00～12:00	フォトマスク用基板	半導体を大量生産する上で無くてはならない回路原版となるフォトマスク基板の現状と2010年以降で量産適応が見込まれるEUVL(Extreme Ultra Violet Lithography)用基板および液晶用マスク基板についてもその概要を紹介する。	HOYA株式会社 先端リソグラフィ開発センター センター長 流川 治
12:00～13:10	昼 食		
13:10～14:10	第6世代ガラス基板用露光装置の概略及び大型液晶露光の課題	ニコンの第6世代ガラス基板用大型露光装置FX-63Sの装置コンセプトと、マルチレンズ・スキャンシステムに関して、概要、開発経緯と主な技術を紹介し、また、今後ますます大型化が予想されるディスプレイの開発に際して、大型露光装置が抱える課題と部材メーカーへの要望等を説明します。	株式会社ニコン 精機カンパニー液晶露光装置事業部第二開発部第一開発課 主任技師 原 典彦
14:10～15:10	半導体ウエハの薄膜化	半導体ウエハの薄膜化は、当初、様々な手法が提案されてきたが、最近では、パッケージ組み立て技術の進歩により、プロセスコストを追求する段階に入ってきた。最新の技術動向に関して解説する。	株式会社ディスコ PSカンパニー 営業技術部 部長 荒井 一尚
15:10～15:20	休 憩		
15:20～16:20	微小薄形チップのピックアップ技術	RFIDタグ組立などの分野においては、微小薄形加工された半導体チップをフィルム上から高速にピックアップする技術が必要である。このニーズを背景に開発された超音波剥離方式について解説する。	株式会社日立製作所 生産技術研究所 プロセスソリューション研究部 主任研究員 井上 康介
16:20～17:20	液晶ディスプレイ用カラーフィルター技術動向とその課題	液晶ディスプレイは従来のパソコン用モニターに加え、テレビやモバイル機器向け等に益々の用途拡大がなされてきている。それら用途拡大に伴い、カラーフィルターに対する性能要求が多様化してきており、それに対応すべき製造技術とその課題について解説する。	大日本印刷株式会社 ディスプレイ製品事業部 ディスプレイ製品研究所 エキスパート 角野 友信

定 員:60名(先着順で定員になり次第締切ります)

参加費:会員(正会員、賛助会員、協賛団体会員)20,000円【資料代込み】、

非会員 30,000円【資料代込み】、

学生会員 無料(資料はありません。資料を希望する場合は4,000円)、

学生非会員 6,000円【資料代込み】

資 料:資料のみ、受講者で資料を2冊以上希望の場合、1冊 4,000円、

* 資料の発送は講習会終了後になります。

【参加費、資料代とも税込み】

申込方法: 申込書に必要事項をご記入の上, 郵送, FAX または学会ホームページにて受け付けます.
申込締切: 平成 16 年 11 月 19 日(金)

申込先: **(社)精密工学会**

(〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-5-9, 九段誠和ビル 2F, 電話 03-5226-5191, Fax 03-5226-5192)
(学会ホームページ <http://www.jspe.or.jp/service/seminar/seminar.html> からも申込出来ます.)